

证券代码：688709

证券简称：成都华微

成都华微电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月6日 14:00-15:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理王策先生，独立董事李越冬女士，总会计师赵良辉女士，董事会秘书李春妍女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 您好，上市公司普遍提高分红比例，请问公司 2023 年度的利润分配方案是怎样的？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.12 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 636,847,026 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 71,326,866.91 元（含税）。本次公司现金红利金额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 22.93%，不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。感谢您的关注。</p> <p>2. 董秘你好，请问公司在所处行业的影响力怎么样？有哪些突出贡献，可以简单说说吗？</p> <p>尊敬的投资者您好！公司作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，连续承接国家“十一五”、“十二五”、“十三五”FPGA 国家科技重大专项，“十三五”高速高精度 ADC 国家科技重大专项、高速高精度 ADC 国家重点研发计划，智</p>

能异构可编程 SoC 国家重点研发计划，是国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。感谢您的关注。

3. 您好，对于 23 年公司封装、检测成本出现变化的原因是什么？

尊敬的投资者您好！2023 年，受过去两年产品销售规模快速提升的影响，加工数量的提升降低了单位加工成本，导致封装成本占比明显降低；同时受特种集成电路可靠性要求提高的影响，产品测试种类和时长增加，导致检测成本明显增高。感谢您的关注。

4. 公司今年 2 月正式在科创板上市，募集了大概 15 亿左右的资金，能否说说这部分资金的利用情况？

尊敬的投资者您好！目前，公司 IPO 募集资金已逐步投入“芯片研发及产业化”与“高端集成电路研发及产业基地”募投项目。针对“芯片研发及产业化”项目，公司积极围绕高性能 FPGA、高速高精度 ADC、自适应智能 SoC 等三个方向的产品研发及产业化，具体投资于硬件购置、软件购置、人员工资等各项研发费用支出。同时，通过“高端集成电路研发及产业基地”项目的实施，公司将进一步建设检测中心和研发中心，打造集设计、测试、应用开发为一体的高端集成电路产业平台，强化巩固公司在特种集成电路领域的核心地位。感谢您的关注。

5. 王总好，1. 公司今年一季度业绩同比有所下降，请问一下具体原因是什么？2. 公司面向的下游市场，产品验收的节奏有什么样的规律？3. 还有从在手订单和交付进展情况来看，公司预计今年接下来业绩会不会反弹？

您好！因经济环境、行业周期等原因，给公司一季度经营情况带来一定影响。公司下游客户主要为特种领域大型集团化客户，根据行业惯例通常在年末进行产品的验收入库及结算。公司目前日常经营活动一切正常，未来也将持续增强高质量发展能力，采取多重举措提升公司整体价值和核心竞争力。感谢您的关注。

6. 王总好，今年以来芯片设计企业普遍反映，半导体行业上游晶圆代工跟封测的成本都有波动。请问对公司来讲，今年代工跟封测的成本有什么样的变化吗？对公司今年毛利率和业绩会不会形成影响？

您好！公司目前日常经营活动一切正常，未来也将持续增强高质量发展能力，采取多重举措提升公司整体价值和核心竞争力。感谢您的关注。

7. 公司产品目前在终端应用方面，有应用到无人机产品当中吗？搭载公司芯片产品的终端产品形态有哪些呢？

您好！目前公司的产品广泛应用于特种领域，涉及电子、通信、控制、测量等技术范畴。公司芯片主要为通用性芯片，从技术角度看，可以覆盖无人机的应用需求，具体销售信息以公司披露信息为准。感谢您的关注。

8. 公司年报里面只是简单地披露了数字电路和模拟电路的收入占比，请问 FPGA 和 ADC 分别的销售收入是多少？存储芯片和电源管理芯

	<p>片的收入是多少？这四部分业务的增长前景和行业竞争情况？</p> <p>您好！公司以服务国家战略、区域发展为己任，始终坚持国家利益优先，聚焦解决集成电路“卡脖子”关键技术，立志成为具有世界一流集成电路研发水平的设计企业。公司立足国之所需，着力打造“3+N+1”平台化产品体系，在超大规模 FPGA、高性能 AD/DA 转换芯片、嵌入式 SoC 与 MCU 三个方向持续强化科研投入，实现技术引领；在 CPLD、存储器、总线接口、电源管理等多个方向以市场需求为导向，推动产业升级。依托公司全系列芯片打造 SiP、模块、板级国产化系统解决方案，形成信号处理与控制的产品生态。感谢您的关注。</p> <p>9. 李总好，请问今年公司的业绩增长动能集中在哪些产品或应用领域？今年下游需求成长是否显著？</p> <p>您好！公司目前核心产品 CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC 处于国内领先地位。已形成逻辑芯片、模拟芯片、存储芯片、微控制器等多系列集成电路产品，具备为客户提供集成电路综合解决方案的能力。未来公司将在超大规模 FPGA、高性能 AD/DA 转换芯片、嵌入式 SoC 与 MCU 三个方向持续强化科研投入，持续增强高质量发展能力，采取多重举措提升公司整体价值和核心竞争力。感谢您的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 7 日</p>